

Laudo Técnico

HS70L SPI PARMi

1 Modelo

HS70L SPI PARMi

2 Marca

PARMI CO, LTD

3 Descrição Técnica do Bem

- Equipamento utilizado para detecção de falhas na aplicação de pasta de solda, realizada pela Impressora de Pasta de Solda (Printer), na linha de montagem de placas eletrônicas (PCB);
- A pasta de solda tem a função de realizar a solda de componentes eletrônicos na PCB. A soldabilidade ocorrerá se for aplicada a pasta de forma correta, considerando-se a quantidade aplicada – área, altura e consequentemente o volume aplicado, se há presença de pasta de solda entre os pontos de aplicação (curto-circuito) e também a posição onde a pasta é aplicada (deslocamento);
- O equipamento executa a inspeção óptica automática das variáveis citadas acima.

4 Aplicação

Inspeção óptica automática de placas eletrônicas em linha de produção, para detecção de falhas na aplicação de pasta de solda efetuada pela impressora de pasta de solda, relativo à posição da aplicação da pasta (deslocamento), altura/área/volume de pasta aplicada em cada ponto de soldagem dos componentes e ausência de curto-circuitos entre os pontos de soldagem.

5 Descrição dos Bens

- O equipamento é composto por 2 projetores angulares antepostos de luz laser e câmera ortogonal, montados em uma cabeça suspensa para captura de imagens 3D da placa a ser inspecionada;
 - Sistema de transporte interno automatizado, de 3 estágios, para operação ininterrupta da linha de montagem, com ajuste automático de abertura para correta transferência da placa a ser inspecionada;
 - Suporte central para compensação de empenamento de placas;
 - Sistema de eixos “X/Y/Z” operado por servomotores e motor de passo para posicionamento preciso da cabeça;
 - Software proprietário para operação, com sistema operacional Windows.
- Fabricação: 16/03/2018

FOTOS	Descrição
1	Máquina para inspeção óptica automática de placas eletrônicas

